

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 4 年 1 月 11 日 (2022.1.11)

【公開番号】特開 2020-141114 (P2020-141114A)

【公開日】令和 2 年 9 月 3 日 (2020.9.3)

【年通号数】公開・登録公報 2020-036

【出願番号】特願 2019-38082 (P2019-38082)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/67 (2006.01)

H 0 1 L 21/52 (2006.01)

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 E

H 0 1 L 21/52 F

H 0 1 L 21/52 C

H 0 1 L 21/78 Y

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 11 月 30 日 (2021.11.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 1】

(a) ダイシングテープと接触する複数のブロックを有し、ダイを前記ダイシングテープの下から突き上げる突上げユニットと、前記ダイを吸着するコレットと、を備える半導体製造装置に、前記ダイシングテープを保持するウェハリングを搬入する工程と、

(b) 前記突上げユニットで前記ダイを突き上げて前記コレットで前記ダイをピックアップする工程と、

を備え、

前記 (b) 工程は、前記突上げユニットの特性を再現させる剥離モデルに対して、前記ダイの前記ダイシングテープからの剥離量と前記ダイ全体の曲げ応力の目標値に前記剥離モデルの出力を追従するようにフィードバック制御し、前記剥離モデルへの制御入力である突上げ量を前記突上げユニットの前記ブロックの突上げ量として前記ダイを突き上げる半導体装置の製造方法。